

证券代码：688603

证券简称：天承科技

上海天承科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参会单位	通过上证路演中心参与“十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会”的投资者
调研时间	2026 年 5 月 8 日（周五）15:00-17:00
会议地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：童茂军 首席技术官：韩佐晏 财务负责人：王晓花 独立董事：石建宾
投资者关系活动主要内容记录	网络文字互动问答 （一）请公司介绍下玻璃基板应用技术上，公司的产业化进展？ 答复： 尊敬的投资者您好，公司 TGV 电镀添加剂已实现批量出货并逐步放量，是部分头部客户核心供应商，目前正配合客户量产计划，推进产业化进程。感谢您的关注！ （二）随着 PCB 迭代，MSAP 是趋势，现在 PCB 板厂都在大规模扩 MSAP 产线，电镀这一块是比较核心的增量环节，请问公司目前在这一块进度？ 答复： 尊敬的投资者您好，公司 SkyStrate VF 系列电镀添加剂适配 MSAP

工艺的不溶性阳极 VCP 设备，支持直流/脉冲填盲孔与 X 型孔，具有低弧挺度、填孔均匀性好、无包心、无化学刮伤等优势，添加剂可 CVS 分析，能满足 MSAP 精细线路与高可靠性填孔需求。SkyStrate VF 系列目前已通过部分 IC 载板厂量产导入。感谢您的关注！

（三）2026 年 Q1 利润增速（+57.8%）远超营收增速（+42.4%），盈利质量提升的驱动因素是否可持续？

答复：

尊敬的投资者您好，公司积极推动高毛利产品如电镀添加剂系列产品推广和销售，持续优化整体的产品销售结构。随着高附加值产品销售占比的提升，公司的盈利能力也稳步增强。其次鉴于公司销售体量逐渐上升，费用占比逐渐降低，产生规模效应，利润率逐渐提升。以上驱动因素为良性可持续，感谢您的关注！

（四）公司目前海外布局的进展如何？

答复：

尊敬的投资者您好，面对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局的变化，公司积极应对并部署发展战略。公司目前已建立了完备的外海团队以及营销渠道铺设，目前持续向海外下游供货中；此外，公司泰国子公司完成设立，目前正在建设工厂中，该工厂用以建立对东南亚地区的供应能力。感谢您的关注！

（五）珠海 3 万吨项目与泰国基地建成后，公司产能将翻几倍？如何消化新增产能并避免毛利率承压？

答复：

尊敬的投资者您好，在当前 AI 算力、人工智能等飞速发展的驱动下，高端 PCB 发展迅速、规模提升。公司积极推进产能建设以应对下游需求量的扩张，其中泰国预计建设 3 万吨产能的生产基地，珠海工厂与泰国工厂完成投产后，产能预计较当前翻 3 倍。公司紧抓国产替代以及客户产品的升级机遇，积极推动产品的推广和销售，将尽快完成后续新工厂产能利用率的提升，感谢您的关注！

（五）半导体材料业务从“客户验证”到“订单放量”需要哪些里程碑条件？

	<p>答复：</p> <p>尊敬的投资者您好，半导体湿电子化学品从客户验证到订单放量，需依次跨越送样检测、产线测试、小批验证、体系审核、定点采购和产能爬坡等关键里程碑，整体周期通常为 6 至 18 个月。首先，客户会对样品的纯度、颗粒度等理化指标进行检测；通过后，在试验线进行测试，验证其对工艺良率和残留的影响；随后在量产线开展小批量运行，评估批次稳定性和设备兼容性；待客户完成对工厂的质量与供应体系审核并纳入合格供应商名录后，双方签署框架协议启动小批量采购；最终随着客户产能扩张或替代竞品，订单逐步放大实现稳定供货。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 9 日